

电子部件用·配线用银胶

用于镀锡部件封装 / 以良好的印刷性形成配线

ST-200、SA-4000、SA-3758、SCE-100、SP-100

电子部件封装、电子部件电极用银胶

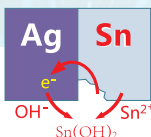
ST-200是利用独有技术针对解决银胶封装时对镀锡部件化学腐蚀的问题。

SA系列具备低接触电阻且高强度接合电子部件的性能。

对镀锡电极部件的高可靠性 (ST-200)



提高树脂的耐水性
抑制劣化



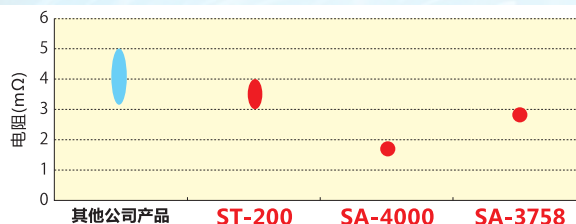
电化学腐蚀的机理

- ① 因与Ag间的电位差Sn离子化
- ② 因水形成Sn氧化皮膜



实现低接触阻抗 (SA系列)

接触电阻的比较 (使用3216部件测试)



ST-200、SA-4000、SA-3758 的参数 (代表值)

项目	ST-200	SA-4000	SA-3758	备注
特点	对应镀锡电极部件	低接触电阻	低收缩, 高强度	
粘度	100 Pa·s	50 Pa·s	40 Pa·s	螺旋粘度计(10rpm, 25°C)
溶剂含量	1 %	4 %	无溶剂	质量分率
粘合剂	环氧树脂	环氧树脂	环氧树脂	
硬化条件	150°C×60min	170°C×60min	170°C×60min	空气炉
体积固有电阻率	$8.0 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	$2.5 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	$5.0 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	
接合强度	70 N	50 N	100 N	搭载3216部件, 平行剪切强度

配线用银胶

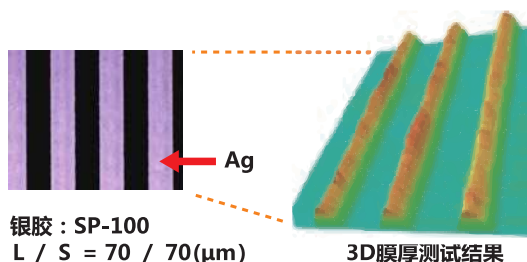
拥有优越的网版印刷性, 电气特性 (低电阻) 的配线用银胶。

优越的印刷性与形状保持性

太阳能电池块的印刷事例



PET膜的印刷事例



SCE-100、SP-100 的参数 (代表值)

项目	SCE-100	SP-100	备注
特点	对应微细间距, 电阻低	对应微细间距, 高密着性	
银含量	88 %	81 %	质量百分浓度
粘度	100 Pa·s	40 Pa·s	螺旋粘度计(10rpm, 25°C)
粘合剂	环氧树脂	环氧树脂	
含有溶剂成分	n-乙二醇丁醚醋酸酯	n-乙二醇单丁醚	
硬化条件	200°C×30min	130°C×20min	空气炉
体积固有电阻率	$1.2 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	$3.0 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	
铅笔硬度	H	H	JIS K 5600